

## 組織委員会

委員長：藤本公三（大阪大学）  
副委員長：青柳昌宏（独）産業技術総合研究所）  
廣瀬明夫（大阪大学）

委員：  
瀨美幸一郎（大阪大学）、荒井栄司（大阪大学）、大西 寛（三菱電機（株））、小勝俊巨（日本電気（株））、小野塚英明（（株）日立製作所）、小林紘二郎（（一財）電子科学研究所、齋藤重正（（同）フロンティア・アライアンス）、佐藤武彦（大阪大学）、佐藤了平（大阪大学）、嶋田勇三（ナミック（株））、菅沼克昭（大阪大学）、高橋康夫（大阪大学）、竹本 正（大阪大学）、田中敏宏（大阪大学）、西田一人（パナソニックアジアパシフィック（株））、貫井 孝（大阪大学）、日置 進（NPO E-TECH）、二上範之（シャープ（株））、益子原學（（株）サイキューブ）、松村慶一（インフイテックエム（株））、南二三吉（大阪大学）、南尾匠紀（パナソニック（株））、宮崎則幸（京都大学）、森 郁夫（（株）東芝）、矢野 映（（株）富士通研究所）、山本治彦（富士通（株））、吉田 隆（富士電機（株））

## 実行委員会

委員長：加柴良裕（大阪大学）  
副委員長：上西啓介（大阪大学） 久保雅男（パナソニック（株））  
福本信次（大阪大学）

委員：  
青島 正貴（トヨタ自動車（株））、赤松俊也（（株）富士通研究所）、浅井康富（（株）デンソー）、朝倉義裕（神戸市立工業高等専門学校）、新井 進（信州大学）、池田 徹（鹿児島大学）、出田吾朗（三菱電機（株））、市村裕司（富士電機（株））、一山靖友（日鉄住金テクノロジー（株））、伊藤元剛（（株）東レリサーチセンター）、井上雅博（群馬大学）、岩田剛治（大阪大学）、于 強（横浜国立大学）、梅本和伸（日本電気（株））、海老原伸明（NEC東芝スペースシステム（株））、大口達也（日本アビオニクス（株））、大熊秀雄（（有）エイチ・ティー・オー）、大貫 仁（茨城大学）、大村悦二（大阪大学）、小川倉一（小川創造技術研究所）、小椋 智（大阪大学）、小野雅史（ニホンハンダ（株））、折井靖光（日本アイ・ピー・エル（株））、鎌田信雄（化研テック（株））、苅谷義治（芝浦工業大学）、菅野敏之（（株）MORESCO）、河野英一（（株）河野エムイー研究所）、小山真司（群馬大学）、阪元智朗（オムロン（株））、作山誠樹（（株）富士通研究所）、佐藤 強（（株）東芝）、佐名川佳治（パナソニック（株））、佐野智一（大阪大学）、穴戸逸朗（京セラサーキットソリューションズ（株））、柴崎正訓（（株）タムラ製作所）、澁谷忠弘（横浜国立大学）、荘司郁夫（群馬大学）、角谷 透（（株）船井電機新応用技術研究所）、節原裕一（大阪大学）、芹沢弘二（千住金属工業（株））、高尾尚史（（株）豊田中央研究所）、高岡英清（（株）村田製作所）、高橋邦夫（東京工業大学）、武井利泰（日本精工（株））、津久井勤（リサーチラボ・ツクイ）、戸井恵子（エスバック（株））、福岡泰造（（株）東芝）、富村寿夫（熊本大学）、豊田良孝（千住金属工業（株））、中村清智（凸版印刷（株））、西浦正孝（パナソニック（株））、西川 宏（大阪大学）、久田隆史（日本アイ・ピー・エル（株））、弘田実保（（株）村田製作所）、藤原伸一（（株）日立製作所）、松坂壮太（千葉大学）、松嶋道也（大阪大学）、松林 良（新電元工業（株））、圓尾弘樹（（株）パナソニックファクトリーソリューションズ（株））、水野 潤（早稲田大学）、宮澤 寛（DOWAメタルテック（株））、村井淳一（三菱電機（株））、村山啓（新光電気工業（株））、森 貴裕（（株）ADEKA）、安田清和（大阪大学）、山内 啓（群馬工業高等専門学校）、山口敦史（パナソニック（株））、山下志郎（（株）日立製作所）、山中公博（中京大学）、山根常幸（（株）東レリサーチセンター）、山部光治（（株）東芝）、横沢伊裕（宇部興産（株））、渡邊 聡（藤倉化成（株））、渡邊 潤（長野沖電気（株））、渡邊裕彦（富士電機（株））

（一部依頼中を含む）



First Circular and Call for Papers 論文募集

# Mate 2016

22nd Symposium on  
“Microjoining and Assembly Technology in Electronics”  
2-3 Feb. 2016, Yokohama

## 第22回

## 「エレクトロニクスにおけるマイクロ 接合・実装技術」シンポジウム

日時：平成28年2月2日（火）、3日（水）

場所：パシフィコ横浜 会議センター  
横浜市西区みなとみらい1丁目1-1

主催：  
（一社）スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会  
（一社）溶接学会 マイクロ接合研究委員会

共催：  
（一社）エレクトロニクス実装学会  
（公社）化学工学会 エレクトロニクス部会  
（一社）レーザ加工学会

協賛：  
応用物理学会、軽金属学会、精密工学会、電子情報通信学会、  
日本機械学会、日本金属学会、日本材料学会、日本溶接協会

（一部依頼中を含む）

＜問合せ先＞  
（一社）スマートプロセス学会  
エレクトロニクス生産科学部会 事務局  
＜ものづくりリエゾンオフィス（MLO）＞

E-MAIL：mate@sps-mste.jp  
PHONE：06-6878-5628 FAX：06-6879-7568

### 開催主旨

日本のエレクトロニクス産業は、この20年間、高機能化、高信頼化、小型化、低コスト化の技術開発に支えられた新たな電子デバイス・部品を組み込んだ電子システム創成の下、日本の高度成長を牽引してきました。今後も日本が世界を先導し続けるには、生産技術を科学的に探求することはもちろんのこと、既存の学問領域、設計・生産技術などの領域を越えて、エレクトロニクスを取巻く科学技術、経営・生産システム、価値システム、などの広い範囲を取り込んだグローバルなオプティマイゼーションとそれに基づくシステムインテグレーションが不可欠になってきています。本シンポジウムは、これら生産技術に関する最新の研究・開発に関する研究者相互の情報交換の場をより広くかつ定期的に持ち、生産の科学と技術の進展を促すことを目的として企画開催されます。



### 論文募集

開催主旨に従い、シンポジウムを開催いたします。つきまして、独創性に富むオリジナル論文(学術論文、研究開発論文)を募集しております。各講演の発表時間は18分(発表12分、質問6分)、発表件数は約100件を予定しております。投稿希望の方はWEB申込みしていただくようお願い申し上げます。学術論文、研究開発論文の区分等に関しましては、申込み者への採択通知送付時に投稿規定とともに送付させていただきます。また申込み多数の場合は、ポスター発表にまわる場合もございます。

### ポスター発表募集

発表者と聴衆が十分に議論できる場として、ポスター発表を設けております。ポスターでの発表希望の方はWEB申込時にポスター発表を選択していただくようお願い申し上げます。発表件数は約20件を予定しております。

### 表彰

本シンポジウムで発表された優秀な論文に対してシンポジウム賞(論文賞、奨励賞)、また優秀ポスター賞および学生の発表に対して優秀発表賞の表彰制度を用意しております。

### 申込方法

下記URLに申込みホームページを設けますので、必要事項を記入して申込みを行ってください。

<http://sps-mste.jp/mate/>

**申込締切：平成27年8月31日(月)**

論文採択決定後、論文発表の場合は4ページ又は6ページの論文を提出、またポスター発表者は2ページの概要を提出してください。原稿様式詳細はホームページを参照してください。

論文提出締切：平成27年11月13日(金)

ポスター発表概要締切：平成27年11月27日(金)

### 参加費

主催団体個人会員	: 20,000円
大学・国公立研究機関	: 20,000円
口頭発表者	: 20,000円
主催団体維持・賛助会員	: 25,000円
共催団体会員	: 25,000円
協賛団体会員	: 30,000円
一般	: 35,000円
学生	: 10,000円

### 会場

パシフィコ横浜 会議センター

- \* みなとみらい線 みなとみらい駅より徒歩3分
- \* JR線・市営地下鉄 桜木町駅より徒歩12分
- \* 横浜駅よりタクシー7分、シーバス(船)で10分



#### カテゴリーA 工法

- A-1 固相接合
- A-2 ソルダリング
- A-3 ろう付
- A-4 溶接
- A-5 接着
- A-6 ナノプロセッシング
- A-7 成膜
- A-8 印刷
- A-9 ビーム加工
- A-10 エッチング
- A-11 マイクロ加工
- A-12 塑性加工
- A-13 その他

#### カテゴリーB 研究・開発の観点

- B-1 金属材料
- B-2 有機材料
- B-3 複合材料
- B-4 加工プロセス
- B-5 アセンブリプロセス
- B-6 メカニズム・現象解析
- B-7 接合・界面構造
- B-8 信頼性
- B-9 解析・シミュレーション
- B-10 機能設計・システム
- B-11 熱マネジメント
- B-12 設備・機器
- B-13 検査・評価
- B-14 計測・分析
- B-15 その他

#### カテゴリーC 対象形態・製品

- C-1 デバイス
- C-2 パッケージ(3D, ウェハレベル等)
- C-3 モジュール(パワー)
- C-4 モジュール(車載, 光, LED等)
- C-5 MEMS・センサー
- C-6 実装部品
- C-7 基板(PCB, インターポーザ等)
- C-8 エネルギー変換機器
- C-9 車載機器
- C-10 通信・携帯機器, コンピュータ
- C-11 光学・表示機器
- C-12 医療・バイオ機器
- C-13 航空宇宙機器
- C-14 その他